

杭州士兰微电子股份有限公司

关于向士兰集科提供关联担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	被担保人关联关系	本次担保金额（万元）	实际为其提供的担保余额（万元） （不含本次担保金额）	是否在前 期预计额 度内	本次担保是否有反担保
厦门士兰集科微电子有限公司	上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体	8,234.10	69,700.94	是	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	524,815.20
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	43.85

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月27日与国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）签署了《保证合同变更协议》，就参股公司厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）在国开行厦门分行的中长期项目融资贷款项下新增的3亿元贷款事宜按27.447%的持股比例提供连带责任保证担保，具体如下：

担保合同名称	保证合同变更协议
签署日期	2026年5月27日
保证人	杭州士兰微电子股份有限公司
被担保人（借款人）	厦门士兰集科微电子有限公司
债权人（贷款人）	国家开发银行厦门市分行
变更前的担保金额	被担保债务的本金为8亿元，公司就被担保债务的27.447%向贷款人提供担保，即担保的债权额为人民币2.19576亿元及其利息、费用等。
变更后的担保金额	被担保债务的本金新增3亿元，公司就被担保债务的27.447%向贷款人提供担保，即新增担保的债权额为人民币0.82341亿元及其利息、费用等。 本次变更后，被担保债务的本金合计为11亿元，公司就被担保债务的27.447%向贷款人提供担保，即担保的债权额合计为人民币3.01917亿元及其利息、费用等。
担保方式	连带责任保证担保
担保期限	三年
是否有反担保	否
是否关联担保	是

上述担保中，士兰集科的另一股东厦门半导体投资集团有限公司的相关方按出资比例同时提供第三方连带责任保证担保；士兰集科以项目形成的主要机器设备同时提供抵押担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议和2026年3月25日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》，同意公司按27.447%的持股比例为士兰集科向国家开发银行厦门市分行申请的3亿元中长期项目融资贷款所对应的0.82341亿元贷款本金及利息等费用提供第三方连带责任保证担保。股东会同时授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。具体内容详见公司于2026年3月10日和2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2026-004、临2026-005和临2026-008。

本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内，无须另行召开董事会及股东会审议。

（三）截至本公告披露日，公司为士兰集科实际提供的担保余额为69,700.94万元（不含本次担保金额），担保余额在公司相关股东会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	厦门士兰集科微电子有限公司		
法定代表人	裴华		
统一社会信用代码	91350200MA31GA8Q1C		
成立时间	2018年2月1日		
注册地	厦门市海沧区兰英路89号		
注册资本	5,309,503,753元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。		
关联关系	本公司董事陈向东先生、范伟宏先生由本公司提名担任士兰集科董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为本公司的关联法人。		
关联人股权结构	<pre> graph TD A[厦门市海沧区人民政府] -- 100% --> B[厦门海沧投资集团有限公司] A -- 100% --> C[厦门海沧发展集团有限公司] B -- 36.11% --> D[杭州士兰微电子股份有限公司] C -- 63.89% --> E[厦门半导体投资集团有限公司] C -- 63.89% --> F[国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司] D -- 27.447% --> G[厦门士兰集科微电子有限公司] E -- 61.987% --> G F -- 10.566% --> G </pre>		
主要财务指标 (万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	1,043,123.94	1,046,704.10
	负债总额	639,749.38	646,131.38
	资产净额	403,374.56	400,572.72
	营业收入	90,879.85	318,746.60
	净利润	2,801.84	-5,738.32

(二) 士兰集科未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证合同变更协议
保证人	杭州士兰微电子股份有限公司
被担保人（借款人）	厦门士兰集科微电子有限公司
债权人（贷款人）	国家开发银行厦门市分行
变更前的担保金额	被担保债务的本金为 8 亿元，公司就被担保债务的 27.447%向贷款人提供担保，即担保的债权额为人民币 2.19576 亿元及其利息、费用等。
变更后的担保金额	被担保债务的本金新增 3 亿元，公司就被担保债务的 27.447%向贷款人提供担保，即新增担保的债权额为人民币 0.82341 亿元及其利息、费用等。 本次变更后，被担保债务的本金合计为 11 亿元，公司就被担保债务的 27.447%向贷款人提供担保，即担保的债权额合计为人民币 3.01917 亿元及其利息、费用等。
担保方式	连带责任保证担保
担保期限	主合同项下债务履行期届满之日起三年
是否有反担保	否
是否关联担保	是

四、担保的必要性和合理性

士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于 12 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司，是公司 12 吋芯片产品的主要供应商。公司本次按持股比例向士兰集科提供担保，有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款，为其 12 吋集成电路芯片生产线的建设和运营提供资金保障，从而为本公司提供产能保障，对本公司的经营发展具有长期促进作用。被担保人士兰集科生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 4 日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、2026 年 3 月 9 日召开的第九届董事会第八次会议和 2026 年 3 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日和 2026 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告，公告编号为临 2026-004、临 2026-

005 和临 2026-008。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额 (万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%)	逾期担保累计金额 (万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	524,815.20	43.85	0
上市公司对控股子公司提供的担保	423,740.00	35.40	0
上市公司对参股公司士兰集科提供的担保	101,075.20	8.45	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0	0

(注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026年5月29日